



Перспективы развития пользовательских интерфейсов

AMD "Athlon II X3 445" (3.10ГГц, 3x512КБ, HT2000МГц) SocketAM3 (Box)

| Параметр | Значение |
|----------------------------------|---|
| Тип разъема | Socket AM3 |
| Тактовая частота | 3.10 ГГц |
| Частота шины HyperTransport | 2000 МГц |
| Ядро | Rana |
| Количество ядер | 3 ядра |
| Кэш L1 (для каждого ядра) | 128 КБ |
| Кэш L2 (для каждого ядра) | 512 КБ |
| Дополнительные инструкции | SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, 3DNow! Professional, MMX(+) |
| Поддерживаемые технологии | AMD Virtualization (AMD-V) Cool'n'Quiet 3.0 |
| Технология изготовления | 0.045 микрон, SOI |
| Напряжение питания | 0.875 - 1.425 В |
| Максимальная выделяемая мощность | 95 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 73 град. |
| Сайт производителя | http://www.amd.ru |
| Производитель | Amd |
| Коробка товара | Ширина: 108 мм. Высота: 115 мм. Глубина: 72 мм. Вес: 0.362 кг. |

Процессор Intel "Celeron Dual-Core E3400" (2.60ГГц, 1024КБ, 800МГц, EM64T) Socket775

| | |
|---|---|
| Тип разъема / корпуса | Socket 775 / PLGA |
| Тактовая частота | 2.60 ГГц |
| Частота внешней шины | 800 МГц |
| Ядро | Wolfdale |
| Количество ядер | 2 ядра |
| Кэш L1 (для каждого ядра) | 32 КБ данные + 32 КБ инструкции |
| Кэш L2 | 1024 КБ |
| Товар без упаковки | Ширина: 38 мм. Высота: 6 мм. Глубина: 38 мм. Вес: 0.023 кг. |
| Дополнительные инструкции | MMX, SSE (SIMD), SSE2, SSE3, EM64T |
| Поддерживаемые технологии | Intel Virtualization (Intel VT) Enhanced Intel Speedstep (EIST) |
| Технология изготовления | 0.045 микрон, медные соединения |
| Напряжение питания | 0.85 – 1.3625 В |
| Максимальная выделяемая мощность | 65 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 74.1 град. |



Процессор Intel "Core i5-3470" (3.20ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 (Box)

| | |
|----------------------------------|---|
| Тип разъема / корпуса | Socket 1155 |
| Тактовая частота | 3.20 ГГц |
| Ядро | Ivy Bridge |
| Количество ядер | 4 ядра |
| Кэш L1 (для каждого ядра) | 32 КБ данные + 32 КБ инструкции |
| Кэш L2 (для каждого ядра) | 256 КБ |
| Кэш L3 | 6 МБ |
| Дополнительные инструкции | MMX, SSE (SIMD), SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AES, EM64T |
| Поддерживаемые технологии | Intel Virtualization (Intel VT) Intel Turbo Boost Enhanced Intel Speedstep (EIST) |
| Технология изготовления | 0.022 микрон, медные соединения |
| Напряжение питания | Нет данных |
| Максимальная выделяемая мощность | 77 Вт |

Материнская плата ASUS P8Z77-V, Z77, Socket 1155, DDR3, ATX



- Персональные особенности
- Наличие Wi-Fi, USB 3.0, SATA3
- Тип разъема процессора
- LGA 1155
- Производитель чипсета
- Intel
- Версия чипсета
- Z77
- Тип оперативной памяти
- DDR3
- Максимальный объем памяти
- 32
- Интегрированное видео
- Поддержка процессорного видео
- Количество PCI Express x16
- 3
- Форм-фактор
- ATX

Материнская плата MSI A55M-P33, A55, Socket FM1, DDR3, mATX



- Тип разъема процессора
- Socket FM1
- Производитель чипсета
- AMD
- Версия чипсета
- AMD A55
- Тип оперативной памяти
- DDR3
- Максимальный объем памяти
- 16
- Интегрированное видео
- Есть
- Количество PCI Express x16
- 1
- Форм-фактор
- mATX

Процессор INTEL Pentium G2130, LGA 1155, OEM



| Гнездо процессора | LGA 1155 |
|------------------------------------|--------------------------|
| Количество ядер | 2 |
| Частота | 3.2 ГГц |
| L3 кэш | 3 МБ |
| Технологический процесс | 22 нм |
| Пропускная способность шины (GT/s) | 5 |
| Частота графического ядра | 650 МГц и 1050 МГц Turbo |

| № п/п | Параметр | Модель 1 | Модель 2 |
|----------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | Торговое название | | |
| 2 | Производитель | | |
| 3 | Год выпуска | | |
| 4 | Такт. частота ядра | | |
| 5 | Такт. частота системной шины | | |
| 6 | Разрядность | | |
| 7 | Объема кэша 1 уровня | | |
| 8 | Объема кэша 2 уровня | | |
| 9 | Объема кэша 3 уровня | | |
| 1 0 | Разъем | | |
| 1 1 | Название ядра | | |
| 1 2 | Количество ядер | | |
| 1 | Назначение | | |

Лёвин К.Г

